

陶瓷基板加工 陶瓷电路板 薄膜电路

产品名称	陶瓷基板加工 陶瓷电路板 薄膜电路
公司名称	富力天晟科技（武汉）有限公司
价格	2.00/件
规格参数	斯利通陶瓷电路板:陶瓷电路板 陶瓷电路板:陶瓷电路板 陶瓷电路板:陶瓷电路板
公司地址	武汉市东湖新技术开发区光谷创业街10栋1单元1层01室383号
联系电话	027-88111056 15527846441

产品详情

公司介绍

富力天晟科技（武汉）有限公司，是一家从事平面、三维无机非金属基电子线路和电子元器件研发、生产、销售为一体的高新技术企业，旗下拥有陶瓷电路板斯利通。

公司主营产品是陶瓷基电路板，如氧化铝陶瓷基、氮化铝陶瓷基、氧化锆陶瓷基、玻璃、石英等，采用激光快速活化金属化技术（Laser Activation Metallization,简称LAM技术）制作。

金属层与陶瓷之间结合强度高、电学性能好，可以重复焊接，金属层厚度在1 μm -1mm内可调，L/S分辨率可达到20 μm ，可直接实现过孔连接，为客户提供定制化生产的贴心服务。

产品在研发和生产过程中已经获得多项发明，相关技术拥有完全自主，目前一期年产能为18000m²。

公司拥有的生产、技术研发团队，先进的营销管理体系以及优质的软、硬件设施。系统化的决策流程，以及严谨的仓储管理体系，为我们产能的高效性提供保障。我们致力于为全球客户提供定制化服务。

品牌介绍-斯利通

作为高新科技+互联网模式的领跑者，我司致力于为每位客户提供高质量的产品以及更贴心的服务。

技术：LAM技术，DPC技术

团队荣誉:武汉国家光电实验室、华中科技大学研发团队，多次参加国际性电子展会.

贴心服务：生产周期快，根据客户的图纸定制化生产

品牌核心：聚焦高技术，走在科技前沿，让技术与产品共同成长，成就不一样的行业品牌.

工艺介绍

LAM技术：我司产品采用国家发明专利激光快速活化金属化技术（Laser Activation Metallization,简称LAM技术）生产，利用高能激光束将陶瓷和金属离子活化，使二者牢固结合。LAM技术可实现单面、双面、三维陶瓷电路板的大规模生产。产品精度高，结合力好，导电层可按客户要求从1 μ m到1mm间定制。其中用纯铜代替银浆可以解决孔的导电和结合力问题，整体性能更加稳定。我们工艺成熟、产品性能优越，激光入射三维面可实现高精度布线。不受外形限制使设计空间更具想象力，成本较传统的技术更低、无需开模、环保无污染，应用领域广泛。

DPC技术：薄膜法是微电子制造中进行金属膜沉积的主要方法，其中直接镀铜 (Direct plating copper)是代表性的。直接镀铜（DPC），主要用蒸发、磁控溅射等面沉积工艺进行基板表面金属化，先是在真空条件下溅射钛，铬然后再是铜颗粒，电镀增厚，接着以普通pcb工艺完成线路制作，再以电镀/化学镀沉积方式增加线路的厚度。